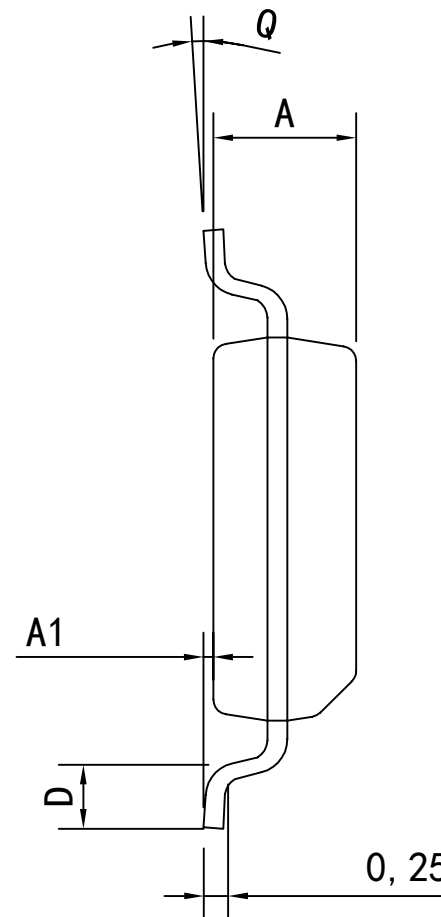
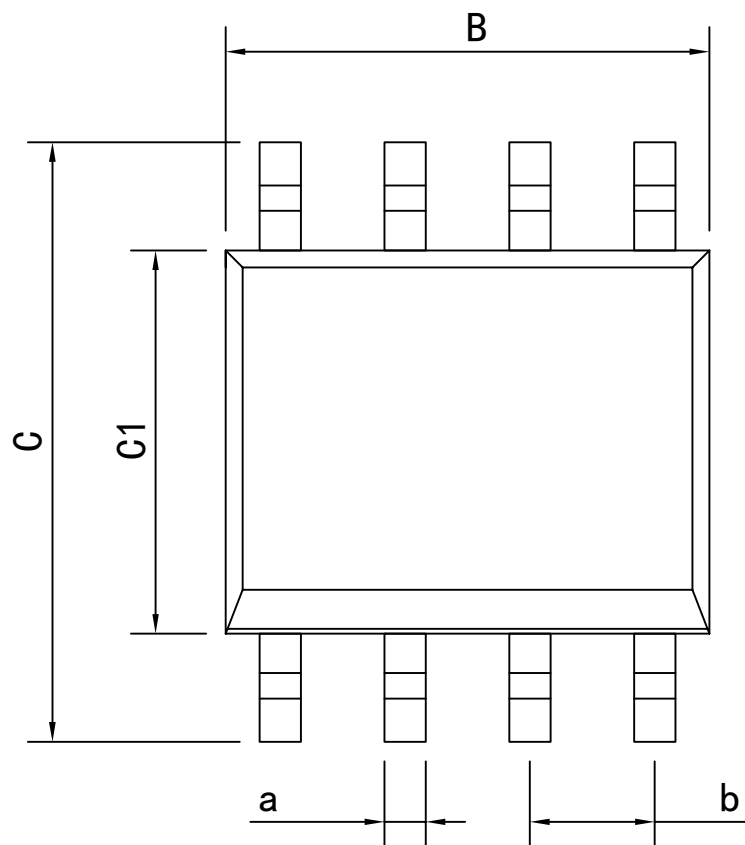




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



| | |
|----|-----|
| 制图 | 赖谊成 |
| 审阅 | 罗云龙 |
| 核准 | 林钟涛 |

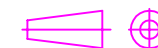
SOP-8

文件名称:
HG-SOP8

文件编号:
HGWXT-230006

| | |
|----|-----------|
| 版本 | VI.0 |
| 比例 | 1:1 |
| 单位 | mm |
| 日期 | 2023-6-27 |

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

| DIM. | A | A1 | B | C | C1 | D | Q | a | b | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|--|--|--|
| MIN | 1.35 | 0.05 | 4.90 | 5.80 | 3.80 | 0.40 | 0° | 0.35 | 1.27 | | | |
| MAX | 1.55 | 0.20 | 5.10 | 6.20 | 4.00 | 0.80 | 8° | 0.45 | BSC | | | |